

(19)  
(12)

(KR)  
(B1)

(51) 。 Int. Cl. 7  
H05K 3/40

(45)  
(11)  
(24)

2003 05 23  
10-0384769  
2003 05 09

(21) 10-2001-0035373  
(22) 2001 06 21

(65)  
(43)

2002-0097437  
2002 12 31

(73) ( ) 1372-7 3 122

(72) 2 1878-5 109 303

(74)  
:

(54) ,

IC ,  
(3) (VIA) BVH() (1) (2) ,  
(4) P/P(5) C/F(6) 가  
가 , 가 ,  
가 가 ,  
가 ,  
가 .

1

1  
2  
A  
B  
C  
D

가 ,

E , P/P

F P/P가 C/F

\*\* \*\*

- 1. 2. 3.
- 4. 5. P/P 6. C/F

IC

(VIA) BHV()

가

( )

가

가  
가

가  
가

가

가

가

가 가

가

가

가

가  
가

가

가

BVH

1 2

가

가

0-36301 )

(1999

561135 ,

200

가

:

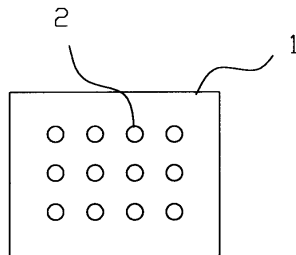




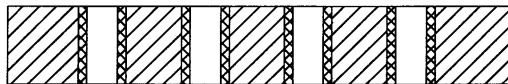
1

- 1 단계 : 홀 가공
- 2 단계 : 무전해와 전기적 도금
- 3 단계 : 홀에 분말 에폭시 수지 투입
- 4 단계 : 릴리지 필름 도포
- 5 단계 : 프리프래그 도포
- 6 단계 : 카파포일 도포
- 7 단계 : 용착 성형

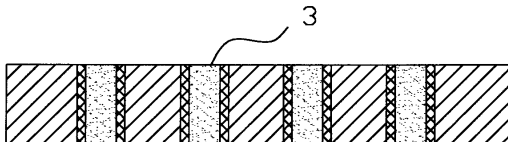
2a



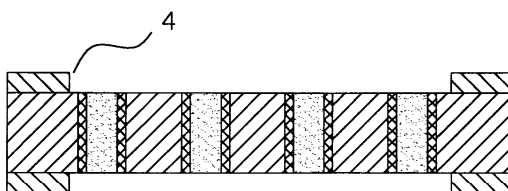
2b



2c



2d



2f

